

上海南芯半导体科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计 90,667.58 万元，累计使用永久补充流动资金 75,060.61 万元，累计利息收入及理财收益 5,290.87 万元（扣除银行手续费），募集资金可用余额为 77,046.39 万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 6,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 71,046.39 万元。

（三）前次募集资金在专户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。

2023年3月14日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东分行、交通银行股份有限公司上海张江支行、兴业银行股份有限公司上海大柏树支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年5月9日，本公司、本公司子公司浙江南芯半导体有限公司与招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004414	2,032.82
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501588062	4,616.99
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	4,810.61
招商银行股份有限公司上海分行	571922593810008	13,042.49
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	18,381.98
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700005811	28,161.50
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004413	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004415	已注销
交通银行股份有限公司上海张江分行	310066865013006606294	已注销
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310855	已注销
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03005244551	已注销
兴业银行大柏树支行	216380100100371052	已注销
上海农商银行张江科技支行	50131000935063329	已注销
合计	——	71,046.39

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 8 月 28 日止，公司募集资金使用总体投入进度已达到 71.49%。截至 2025 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经 2025 年 3 月 25 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过同意公司将原募投项目“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实施主体为浙江南芯半导体有限公司，项目总投资 144,250.24 万元，分两期进行建设，一期投入 71,287.30 万元，二期投入 72,962.94 万元。

“测试中心建设项目”变更主要是基于对市场和行业发展趋势的把握，为满足公司发展战略的规划，将“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设项目”，能够为公司研发和生产国产芯片提供基础保障；通过芯片测试研发和生产的一体化，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提高生产效率，降低不良率和售后服务成本，提升公司产品质量管理水平；同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应，有利于公司降低产品测试成本；能够提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模的提升，尤其是车规业务规模的发展，符合公司长期发展战略。因此，公司将原“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实际变更募集资金 27,323.64 万元及其孳息 1,036.21 万元用于“芯片测试产业园建设项目”，同时实际使用剩余超募资金 29,684.23 万元及其孳息 1,687.01 万元增加投资额，合计实际使用募集资金 57,007.87 万元及其孳息 2,723.22 万元用于“芯片测试产业园建设项目”一期投资。其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。变更募集资金金额为 57,007.87 万元，占募集资金总额的比例 24.00%。

2025 年 3 月 4 日，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项发表核查意见，同意上述事项。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资先期投入项目转入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,136.55 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金为人民币 567.15 万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币 5,703.70 万元。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

2024 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为 6,000.00 万元。

2、公司尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金净额 237,483.71 万元，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计 90,667.58 万元，累计使用永久补充流动资金 75,060.61 万元，累计利息收入及理财收益 5,290.87 万元（扣除银行手续费），募集资金可用余额为 77,046.39 万元。公司累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 6,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 71,046.39 万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“测试中心建设项目”作为公司研发能力提升建设项目，不产生直接的经济效益，但项目实施后可增强公司的综合研发实力，建立起更高的技术壁垒，加强技术复用，实现规模化扩张，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。

“补充流动资金”和“超募资金永久补充流动资金”项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：				237,483.71			已累计使用募集资金总额：			165,728.19	
变更用途的募集资金总额：				57,007.87			各年度使用募集资金总额：				
							2023 年：			86,557.84	
变更用途的募集资金总额比例：				24.00%			2024 年：			59,707.07	
							2025 年 1-6 月：			19,463.28	
投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目		实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目		高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目	45,686.45	45,686.45	44,596.14	45,686.45	45,686.45	44,596.14	-1,090.31	2025 年 12 月
2	高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目		高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	22,717.78	22,717.78	18,696.41	22,717.78	22,717.78	18,696.41	-4,021.37	2025 年 12 月
3	汽车电子芯片研发和产业化项目		汽车电子芯片研发和产业化项目	33,484.43	33,484.43	23,539.32	33,484.43	33,484.43	23,539.32	-9,945.11	2025 年 12 月
4	测试中心建设项目		测试中心建设项目	30,910.82	3,587.18	3,587.18	30,910.82	3,587.18	3,587.18	-	2025 年 12 月
5	芯片测试产业园建设项目一期		芯片测试产业园建设项目一期	-	27,323.64	248.53	-	27,323.64	248.53	-27,075.11	2031 年 2 月
6	补充流动资金		补充流动资金	33,000.00	33,000.00	33,060.61	33,000.00	33,000.00	33,060.61	60.61	不适用
承诺项目小计			——	165,799.48	165,799.48	123,728.19	165,799.48	165,799.48	123,728.19	-42,071.29	——
超募资金投向											
1	超募资金永久补充流动资金		超募资金永久补充流动资金	-	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	-	不适用
2	超募资金用于芯片测试产业园建设项目一期		超募资金用于芯片测试产业园建设项目一期	-	29,684.23	-	-	29,684.23	-	-29,684.23	2031 年 2 月
超募资金投向小计			——	-	71,684.23	42,000.00	-	71,684.23	42,000.00	-29,684.23	——

合计	——	165,799.48	237,483.71	165,728.19	165,799.48	237,483.71	165,728.19	-71,755.52	——
----	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月		
1	高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	汽车电子芯片研发和产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	测试中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	芯片测试产业园建设项目一期	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向								
1	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	超募资金用于芯片测试产业园建设项目一期	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用